(articolo 5)

Applicazioni esentate dai requisiti di cui all'articolo 5^[1]

1. Mercurio in sorgenti luminose fluorescenti compatte, sino ad un massimo di 5 mg per lampada.

2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici sino ad un massimo di:

- alofosfato	10 mg
- trifosfato con tempo di vita normale	5 mg
- trifosfato con tempo di vita lungo	8 mg

3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.

4. Mercurio in altre sorgenti luminose non espressamente menzionate nel presente allegato.

5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti.

6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.

7. - Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe per saldature a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo),

- Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria a array, apparecchiature di commutazione, segnalazione e trasmissione per reti infrastrutturali come pure per reti di gestione per le telecomunicazioni,

- Piombo nei componenti ceramici (per esempio nei dispositivi piezoelettrici).

8. Cadmio e suoi componenti nei contatti elettrici e nelle placcature a base di cadmio, ad eccezione delle applicazioni vietate a norma della *direttiva 91/338/CEE* recante modifica della *direttiva 76/769/CEE* relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

Piombo usato nei sistemi di connessione a pin.

Piombo utilizzato come rivestimento di C-ring nei moduli di conduzione termica.

Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.

Piombo in saldature composte da più di due elementi, per la connessione fra i piedini e l'involucro dei microprocessori, con un contenuto in piombo tra l'80% e l'85% in peso.

Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati flip chip.

Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1% in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01% in peso di cadmio; per materiale omogeneo si intende un'unità che non può essere meccanicamente disaggregata in più materiali separati.